



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 24

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 施加的压力       | 标准       |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |
| 连接器系统       | 板对板      |
| Sealable    | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 行数                  | 2  |
| 可堆叠                 | 是  |
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| Number of Positions | 24 |
| 板对板配置               | 平行 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 介质耐压（最大值）         | 750 VAC |
| 绝缘电阻              | 5000 MΩ |
| Operating Voltage | 333 VAC |

主体特性

|       |   |
|-------|---|
| 连接器外形 | 低 |
|-------|---|

接触件特性



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子保护类型           | 闭合入口壳体           |
| 端子接触部长度          | 3.77 mm[.148 in] |
| 接合方柱尺寸           | .64 mm[.025 in]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 – 7.61 µm   |
| 端子形状和构造          | 圆形, 圆形, 短点       |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡铅               |
| 端子基材             | 磷青铜              |
| 端子接触部电镀材料        | 金                |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | .762 µm[30 µin]  |
| 端子类型             | 插座               |
| 端子额定电流（最大值）      | 2 A              |

端接特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in]   |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .7 mm[.028 in]   |
| 端接柱体和尾部长度   | 3.18 mm[.125 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接          |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 接合入口位置  | 顶部             |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | 热塑性            |

尺寸

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 连接器高度              | 5.03 mm[.198 in]        |
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in]          |
| 堆叠高度               | 9.02 mm[.355 in]        |
| PCB 厚度（建议）         | 1.57 mm[.055 – .094 in] |

使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 标准                         |
| 工作温度范围  | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座    |
| 电路应用   | Signal |

行业标准

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 已批准的标准   | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0              |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装数量 | 18        |
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |

其他

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 注释 | TE 建议使用接合金或带双层电镀母端配件的双层电镀公端。 , 为了获得最小接合柱长度，在最大触点尺寸上增加 .51 [.020]（不包含斜面上的柱引线）。 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 240°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。





免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 86286-1  
KEYING PLUG

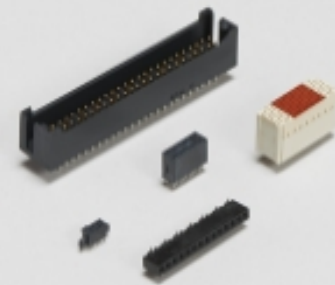
该系列中的其他产品 | Modu Connector System



PCB 连接器盖(4)



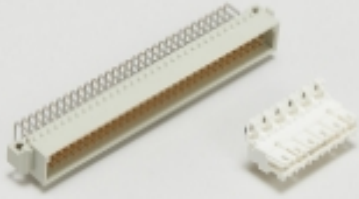
PCB 连接器键控(4)



板对板接头和插座(1243)



板对板跳线和分路(5)



标准边缘连接器(2)

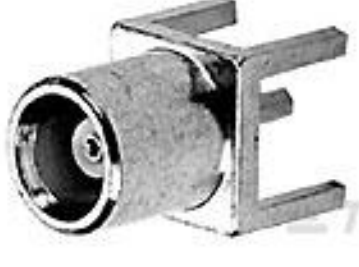


汽车连接器护套(3)

客户还购买了



TE 产品编号1-332070-4  
SOCKET,MIN-SPR W/H AU SER-4



TE 产品编号1060995-1  
5862 5004 09, OSX PCB JACK RECP



TE 产品编号YDTS26W11-98PNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号1241152-5  
5P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER



TE 产品编号1-1734264-1  
[M/J,RJ45,Side entry,8P8C,R/A,1](#)

TE 产品编号1-534998-0  
[20 MODIV VRT DR CE 100/125](#)

TE 产品编号1-534998-5  
[30 MODIV VRT DR CE 100/125](#)

TE 产品编号103735-4  
[05 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)

TE 产品编号1059716-1  
[4582 2240 02](#)

TE 产品编号1612963-4  
[2MM PITCH BATTERY REC. ASSY 10P, L=5](#)

文档

产品图纸

[24 MODIV VRT DR CE 100/125](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-534998-2\\_R.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-534998-2\\_R.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-534998-2\\_R.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本